

國立勤益科技大學
112 學年度四技產學合作學士海外青年
半導體製造實務專班學分計畫表

112 學度入學適用
112.05.04 系課程會議暨系務會議審議通過
112.05.17 院課程會議審議通過
112.06.01 校課程委員會議及 112.06.15 臨時教務會議審議通過

第一學年			第二學年						第三學年						第四學年													
科 目	上學期			下學期			科 目	上學期			下學期			科 目	上學期			下學期			科 目	上學期			下學期			
	學分	正課	實習	學分	正課	實習		學分	正課	實習	學分	正課	實習		學分	正課	實習	學分	正課	實習		學分	正課	實習	學分	正課	實習	
共 同 科 目 (24 學分)																												
華語聽說(一)	3	5	0				華語聽說(三)	3	3	0																		
華語讀寫(一)	3	5	0				體育(三)	0	2	0																		
華語輔導課程	0	5	0				體育(四)			0	2	0																
體 育 (一)	0	2	0																									
英文聽與說(一)	3	3	0																									
英文聽與說(二)				3	3	0																						
華語聽說(二)				3	5	0																						
華語讀寫(二)				3	5	0																						
體育(二)				0	2	0																						
藝術鑑賞				1	1	0																						
微積分				2	2	0																						
必 修 小 計	9	20	0	12	18	0	小計	3	5	0	0	2	0															
基 礎 科 目 (32 學分)																												
專 業 外 語 (一)	3	3	0				產業製造程序實習 (一)	3	0	6				產業製造程序實習 (三)	3	0	6											
人 際 溝 通	3	3	0				產業生產設備實習 (一)	3	0	6				產業生產設備實習 (三)	3	0	6											
工程實務訓練 (一)	1	1	0				產業製造程序實習 (二)			3	0	6																
專 業 外 語 (二)				3	3	0	產業生產設備實習 (二)			3	0	6																
勞 動 法 規				3	3	0																						
工程實務訓練 (二)				1	1	0																						
小 計	7	7	0	7	7	0	小計	6	0	12	6	0	12	小計	6	0	12	0	0	0	小計	0	0	0	0	0	0	0
專 業 科 目 (38 學分)																												
							程 式 設 計	3	3	0				半 導 體 元 件 概 論	3	3	0				積 體 電 路 封 測 實 務	3	3	0				

						電腦軟體應用與設計	3	2	2				計算機組織	2	1	2			積體電路製程實務				3	3	0		
						工業 4.0 概論				3	2	1	資料結構(一)	2	1	2			機電整合實務				3	3	0		
						數位邏輯與實習				2	1	2	資料結構(二)			2	1	2									
						基本電學				3	3	0	機器學習			3	3	0									
													資料庫管理系統實務			3	2	1									
小計						小計	6	5	2	8	6	3	小計	7	5	4	8	6	3	小計	3	3	0	6	6	0	
共同選修						全民國防教育軍事訓練(一)	1	2	0				體育選修	1	2	0			體育選修	1	2	0					
						全民國防教育軍事訓練(二)				1	2	0	全民國防教育軍事訓練(四)			1	2	0			體育選修			1	2	0	
						生命關懷實務	3	3	0																		
	小計	1	2	0	1	2	0	小計	4	5	0	1	2	0	小計	1	2	0	1	2	0	小計	1	2	0	1	2
專業選修科目																											
						半導體元件概論	3	2	1				AI 實務專題(I)	3	2	1			產學合作專題(一)	3	2	1					
						智慧製造實務技術	3	2	1				智慧機械APP設計實務	3	2	1			機器人學	3	2	1					
						積體電路封裝製程實務(一)	3	2	1				機械與自動控制	3	2	1			測試製程實務	3	2	1					
						VLSI 概論	3	2	1				積體電路封裝製程實務(二)	3	2	1			封裝結構力學	3	2	1					
						半導體產品概論	3	2	1				AI 實務專題(II)			3	2	1	科技報告寫作	3	3	0					
						智慧機械概論	3	2	1				智慧機械SMB實務			3	2	1	產業產品組裝實習(二)	6	0	24					
						科技英文	2	2	0				覆晶技術製程實務			3	2	1	產學合作專題(二)				3	2	1		
						半導體製程概論				3	2	1	AOI 工程應用實務			3	2	1	積體電路封裝製程實務(三)				3	2	1		
						電子電路概論				3	2	1	凸塊技術製程實務			3	2	1	工業機械手臂實務				3	2	1		
						電腦輔助繪圖				3	2	1	生涯規劃			3	3	0	AI 產業應用實務				3	2	1		
													產業產品組裝實習(一)			6	0	24	半導體元件				3	2	1		
																			產業產品組裝實習(三)				6	0	24		
必修科目學分/時數	16	27	0	19	25	0	必修科目學分/時數	15	10	26	14	8	27	必修科目學分/時數	13	5	28	8	6	3	必修科目學分/時數	3	3	0	6	6	0
備註	<p>1. 畢業至少應修滿 128 學分【必修 94 學分，選修至少 34 學分(其中至少需含本系專業必選修科目 30 學分)】。</p> <p>2. 學生須於一年級第二學期結束前通過「華語文能力測驗 A2 級」，未通過者逕予退學。</p>																										

